

FL 22 FLUTSCHI Flußmittelgel / Flux Gel

Löten von SMT und Fine-Pitch-Bauteilen -
mit den EDSYN-MINI-FLOW-Lötspitzen und dem
Flußmittelgel FL 22 ein Kinderspiel

EDSYN MINI FLOW Tips and FL 22 flux gel - make soldering of
SMD and fine pitch components as easy as pie



Vorteile:

- * **NO CLEAN - Flußmittel**
- * leichte Handhabung
- * leichte Dosierspritze
- * hervorragend geeignet für Fine-Pitch- und SMD-Anwendungen
- * einwandfreie Lötergebnisse beim Einsatz mit Heißluft- und LötKolben, auch mit MINI FLOW Lötspitzen
- * schnelle Reparaturen werden möglich
- * Flußmittelgel kann sich nicht so schnell wie Flußmittel auf Alkoholbasis verflüchtigen
- * Aktivierung von verschmutzten Pads und Bauteilbeinchen

Advantages:

- * **NO CLEAN - flux**
- * easy handling
- * light weight proportion syringe
- * ideal for fine pitch and SMD applications
- * perfect soldering results with hot air tools and soldering irons; excellently suited for MINI FLOW soldering tips
- * enables quick repair
- * lower volatility than alcohol-based fluxes
- * activation of dirty pads and component legs

FL 22 FLUTSCHI Flußmittelgel / Flux Gel

Löten von SMT und Fine-Pitch-Bauteilen -
mit den EDSYN-MINI-FLOW-Lötspitzen und dem
Flußmittelgel FL 22 ein Kinderspiel

EDSYN MINI FLOW Tips and FL 22 flux gel - make soldering of
SMD and fine pitch components as easy as pie



Mit **FL 22 FLUTSCHI** Flußmittelgel wird über eine konische Dosierspitze, Flußmittel gezielt und sparsam auf SMD-Pads oder zu lötfende Flächen aufgetragen. Danach können herkömmliche Lötstellen leicht und einfach gelötet werden.

SMD-IC's nach dem Positionieren an den Beinchen leicht mit Flußmittelgel benetzen. Danach wird mit einem LONER SMD Lötgerät und der EDSYN - MINI FLOW Lötspitze Lot an den Pads und Beinchen aufgetragen. Kinderleicht gelingt das Anlöten von schwierigsten Bauteilen.

Bei sorgfältiger Dosierung verbleiben kaum Rückstände auf der Leiterplatte, die in der Regel keine Beeinflussung auf die Lötstelle haben.

In der Praxis hat sich gezeigt, daß aufgrund des niedrigen Feststoffgehaltes auf das Waschen der mit diesem Flußmittel gelöteten Leiterplatten in der Regel verzichtet werden kann.

Die Flußmittelzusammensetzung entspricht **F-SW 33 (DIN 29 454 / 1.2.3.A - DIN 8511)**.

The conical proportioning tip of FL 22 FLUTSCHI allows controlled and sparing application of flux to SMD pads or any surfaces to be soldered. You can then easily solder regular joints.

First, flux is sparingly applied to the legs of properly positioned SMD ICs. Then solder is applied to pads and legs using a LONER SMD soldering tool fitted with an EDSYN MINI FLOW tip. Now even the most demanding soldering applications are no longer a problem.

Flux residues, which hardly occur when **FL 22 FLUTSCHI** is carefully applied, usually do not affect the soldering joint.

Practice has shown that using this flux with its low solids content usually eliminates the need for washing the soldered circuit board.

The composition of this flux complies with **F-SW 33 (DIN 29 454/1.2.3.A - DIN 8511)**

Inhalt: 5 ml
Flußmitteltyp: DIN EN 29454 / 1.2.3. **F-SW 33**
Vorsicht:
* von Zündquellen fernzuhalten
* nicht rauchen
* Behälter dicht geschlossen halten
* Zündpunkt: **420°C**

Content: 5 ml
Flux type: DIN EN 29454 / 1.2.3. - F-SW 33
Precautions:
* keep away from ignition sources
* do not smoke
* keep container tightly closed
* ignition point 420 °C